

武汉港迪技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-005

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与港迪技术（301633）2025年第三季度业绩说明会的全体投资者
时间	2025年10月27日 15：00-16：00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长：向爱国 财务总监：张丽娟 保荐代表人：凤伟俊 董事会秘书：周逸君 独立董事：牛红彬
投资者关系活动主要内容介绍	1、前三季度公司研发投入占比超过 10%，研发成果如何？相关高科技产品的应用情况如何？ 答：尊敬的投资者您好！公司高度重视技术与产品的持续创新，2022-2024 年，公司研发费用分别为 3,371.20 万元、4,042.29 万元、4,816.10 万元，占营业收入比重分别为 6.65%、7.39%、8.00%，2025 年 1-9 月公司研发费用为 3,618.37 万元，同比增加 15.39%，占营业收入比重为 10.03%，研发投入持续增加。 今年以来，公司继续加强工程型单传动风冷变频器、工程型水冷变频器、超大直径盾构机刀盘水冷变频驱动系统、桥机专用

	变频器、智能操控系统等产品的研发和技术迭代，取得了较好的成果。 在自动化驱动相关产品方面，公司自主研发的 HF680N 系列 2400kW 大功率能量回馈多传动系统成功应用于 900 吨和 1200 吨大型造船龙门吊，展现了公司的核心技术，标志着港迪技术在高端工业自动化核心部件领域的持续突破，为我国造船行业注入新动能；世界最大直径全断面硬岩竖向掘进机“一钻成井”落底贯通，公司为相关掘进机提供刀盘变频柜（水冷）、回排水泵变频柜（风冷）、泥浆泵变频柜（风冷）等产品，助力国家重大工程顺利推进。公司自主研发的盾构机一体化专机在南水北调中线引江补汉工程、环北部湾广东水资源配置工程、拉萨旁多输水洞工程、都江堰供排水系统提升工程等重大水利工程建设中得到广泛应用。 在智能操控系统产品方面，自主研发的集装箱场桥自动化作业系统，采用自主研发的安全防护、智能识别与定位等子系统，深度融合视觉 AI 与激光雷达等多模态感知技术，功能持续迭代升级，满足集装箱场桥作业全场景需求。 在管理系统软件产品方面，凭借深厚的行业积累和对智能化趋势的前瞻洞察，推出基于 RAG（检索增强生成）与知识图谱的运维助手，构建融合垂域知识管理、智能推理、决策支持的运维中枢，实现从“被动响应”到“智能诊断”的范式转移，大幅提升智能运维水平。 感谢您的关注与支持！ 2、公司中高压变频器研发进展如何，何时规模化销售？未来在中高压变频器领域的发展规划是什么？ 答：尊敬的投资者您好！目前，该业务线进展顺利，已有部分机型进入测试验证阶段，预计年内可推向市场。公司作为工业自动化领域的国家级专精特新“小巨人”企业，其中高压变频器产品的发展规划紧密围绕技术升级、场景拓展、全球化布局三大核心展开，并与现有自动化驱动产品、智能操控系统形成深度协同，打造“驱动-控制-管理”全链条产品线。在业务拓展方面，充分利用现有下游客户的熟悉程度，加快行业定制化开发，绑定
--	---

	和深耕现有客户，积极拓展新客户，扩大产品销量。感谢您的关注与支持！ 3、海外市场拓展进展情况？ 答：尊敬的投资者您好！公司为加速海外布局，积极开展海外业务沟通，通过增设组织机构、增加专业人才等壮大海外团队，为海外业务发展提供了坚实支撑，感谢您的关注与支持！ 4、公司未来 3-5 年的目标和规划 答：尊敬的投资者您好！公司将以“可持续、高质量发展”为目标，持续加大技术研发、新产品开发及海外市场拓展力度，不断延伸产业链长度、深化服务深度，坚定走“高端化、差异化、软硬件一体化”的产品发展路线，同时聚焦国产替代领域与工业自动化、智能化场景的定制服务，通过多维度布局强化核心竞争力，支撑公司长期稳健发展。感谢您的关注与支持！ 5、公司未来在人才引进，特别是高端技术人才方面有什么计划？ 答：尊敬的投资者您好！人才是公司核心资产，未来，我们将继续围绕公司的战略方向，积极引进高端技术人才和复合型人才，并通过股权激励等多元化激励手段，吸引和留住优秀人才，为公司的创新发展提供持续动力。感谢您的关注与支持！ 6、公司对半导体行业的市场看法及规划 答：尊敬的投资者您好！半导体行业属于国家战略新兴产业，市场容量大，发展速度快，技术迭代也快，目前受益于 AI、5G、新能源汽车等下游需求爆发，全球及国内市场均持续火热。 伺服系统为半导体产业链中关键的精密执行部件，用来精确控制各类部件或设备的动作，高精度完成各项指令。公司自主研发的 SD400 系列伺服系统，凭借超快速响应、高精度位置控制、高稳定性以及紧凑的设计等特性，已实现对半导体行业核心设备（贴片机芯片拾取定位、划片机晶圆切割轨迹控制）的适配，可有效帮助下游客户提升设备生产良率与作业效率，相关产品正逐步推向市场。感谢您的关注与支持！ 7、请问公司净利润同比下降的原因 答：尊敬的投资者您好！今年前三季度公司净利润同比小幅下降，主要原因及应对措施如下：（1）主要原因：为拓展销售
--	--

	规模、强化长期竞争力，公司针对性增加了三方面投入：销售端加大市场开拓力度，研发端聚焦产品创新升级，管理端优化运营体系，上述三项费用均有合理增长。（2）应对措施：为改善盈利水平，公司已明确三大发力方向：一是增收扩市，进一步扩大产品销售规模，拓展优质市场渠道，提升核心产品的市场占有率。二是加速回款，加强应收账款管理，加快项目资金回笼，提升资金周转效率，为利润增长提供支撑。三是降本增效，通过优化成本结构、提升运营效率，减少不必要开支，实现资源精准投放。后续公司将持续落实上述举措，力争推动营收与利润规模稳步提升，切实保障投资者权益。感谢您的关注与支持！
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	
日期	2025年10月27日